

檔 號：

保存年限：

國立臺北科技大學 函

北科大等2校合辦114年「半導體IC晶片封測製程技術菁英人才培育計畫」課程資訊，已公告週知。

敬陳
生涯發展中心主任

地址：106344臺北市大安區忠孝東路三段一號
承辦人：賴建成
電話：2771-2171#6020
電子信箱：lks@ntut.edu.tw

生涯發展中心
承辦人 林敬堂 0616
1453

受文者：文藻學校財團法人文藻外語大學

發文日期：中華民國114年6月16日
發文字號：北科大產學字第1147900178號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：114年半導體IC晶片封測製程技術菁英人才培育計畫課程表、114年半導體IC晶片封裝製程技術菁英人才培育計畫海報 (XC760004240000000_114F900541_1_16102312877.pdf, XC760004240000000_114F900541_2_16102312877.pdf)

主旨：檢送本校與明新科技大學半導體學院合作辦理114年「半導體IC晶片封測製程技術菁英人才培育計畫」課程資訊（詳如說明），敬邀貴校學生踴躍報名參加，並請協助公告，請查照。

說明：

- 一、本課程旨在培育具備產業即戰力的半導體技術人才，內容涵蓋台灣在全球半導體產業中的戰略地位、產業鏈介紹、技術趨勢解析，以及半導體在日常生活中的應用等理論基礎；實作課程的部分，學員將親自操作晶圓切割機、打線機、黏晶機等封裝設備，並進行功率IC測試設備操作訓練，包括晶圓針測試機與高功率元件測試機等，深入了解2D/3D封裝、WLP與PLP等先進製程技術。透過理論與實務並重的安排，幫助學生建立完整的半導體封測技術知識體系，奠定相關職能基礎。
- 二、報名資格：國內各公私立大專校院之在學學生。
- 三、課程時間：114年7月17日（四）、114年7月18日（五）共計2天，凡符合報名資格且參與全程課程者，於課程結束

後擇期核發研習時數證明電子檔。

四、課程地點：明新科技大學逢喜樓209教室、明新科技大學半導體人才培育基地(新竹縣新豐鄉新興路1號)。

五、人數上限：實體30人(無線上課程)。

六、報名時間：即日起至114年7月14日(一)17:00為止(如人數額滿將提前截止)。

七、報名網址：<https://forms.gle/jXWh6J3RfEPsDRav9>

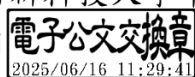
八、聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學賴專員，連絡電話:(02)2771-2171分機6020，電子郵件：lks@mail.ntut.edu.tw

九、本課程與美銘國際科技有限公司、力成科技股份有限公司合作辦理。

十、檢附114年「半導體IC晶片封測製程技術菁英人才培育計畫」課程表、海報。

正本：各公私立大專校院

副本：本校產學處、明新學校財團法人明新科技大學半導體學院、美銘國際科技有限公司、力成科技股份有限公司



114 年「半導體 IC 晶片封測製程技術菁英人才培育計畫」課程表

課程日期：114 年 7 月 17 日(四)~7 月 18 日(五)

課程地點：明新科技大學逢喜樓 209 教室、明新科技大學半導體人才培育基地 (新竹縣新豐鄉新興路 1 號)

報名網址：<https://forms.gle/jXWh6J3RfEPsDRav9>

課程內容：



日期	時間	課程單元主題/內容	授課教師	課程地點
7/17 (四)	08:45-09:00	報 到		明新科技大學 逢喜樓 209 教室
	09:00-10:00	• 晶片戰~台灣的矽盾 AI與半導體 探討台灣半導體產業的崛起及其 在全球供應鏈中的關鍵角色	律芯科技股份 有限公司 薛宗智董事長 兼執行長	
	10:00-11:00	• 全球半導體市場與趨勢解析 1. 一次看懂晶片產業 2. 半導體產業鏈介紹		
	11:00-12:00	• 揭開半導體的神秘面紗 你所不知道的半導體日常		
	12:00-13:00	午 餐		明新科技大學 半導體人才 培育基地
	13:00-17:00	• 半導體封裝設備實務操作 1. 晶圓切割機操作實務 2. 打線機操作實務 3. 黏晶機操作實務	力成科技股份有限公司 林賢昇資深工程師 黃志賢資深工程師 明新科技大學郭人榮講師	
	17:00-18:00	綜 合 討 論		
7/18 (五)	08:45-09:00	報 到		明新科技大學 逢喜樓 209 教室
	09:00-12:00	• 積體電路封裝製程技術 1. 半導體封裝技術演變 2. 2D及3D封裝製程 3. 先進封裝工程概論 a. 晶圓級封裝(WLP)製程 b. 平板級封裝(PLP)製程	明新科技大學 半導體學院 趙守嚴副院長	
	12:00-13:00	午 餐		
	13:00-17:00	1. 半導體功率IC測試系統介紹 2. 半導體測試設備實務操作 a. 晶圓針測試機操作訓練 b. 電源IC元件測試機操作訓練 c. 高功率分離式元件測試機操作 訓練	美達科技公司 劉文正副理 明新科技大學郭人榮講師	明新科技大學 半導體人才 培育基地
	17:00-18:00	綜 合 討 論		

2025 半導體IC晶片封裝製程 技術菁英人才培育計畫



日期

114年7月17日(四)
7月18日(五)



地點

明新學校財團法
人明新科技大學
半導體學院

主辦單位：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學
明新學校財團法人明新科技大學半導體學院
協辦單位：美銘國際科技有限公司
力成科技股份有限公司